

锦州神工半导体股份有限公司

2025 年年度业绩预告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 经财务部门初步测算，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年年度实现营业收入为 43,000.00 万元到 45,000.00 万元，与上年同期相比增加 12,727.05 万元到 14,727.05 万元，同比增长 42.04%到 48.65%。
- 预计 2025 年年度净利润实现 11,000.00 万元到 13,000.00 万元，与上年同期相比增加 6,325.17 万元到 8,325.17 万元，同比增长 135.30%到 178.09%。
- 预计 2025 年年度归属于母公司所有者的净利润实现 9,000.00 万元到 11,000.00 万元，与上年同期相比增加 4,884.93 万元到 6,884.93 万元，同比增长 118.71%到 167.31%。
- 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,800.00 万元到 10,800.00 万元，与上年同期相比增加 4,965.66 万元到 6,965.66 万元，同比增长 129.50%到 181.66%。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 业绩预告情况

- 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现营业收入为 43,000.00 万元到 45,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 12,727.05 万元到 14,727.05 万元，同比增长 42.04%到 48.65%。

2、公司预计 2025 年年度实现净利润为 11,000.00 万元到 13,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 6,325.17 万元到 8,325.17 万元，同比增长 135.30% 到 178.09%。

3、公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,000.00 万元到 11,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 4,884.93 万元到 6,884.93 万元，同比增长 118.71% 到 167.31%。

4、公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,800.00 万元到 10,800.00 万元，与上年同期相比，将增加 4,965.66 万元到 6,965.66 万元，同比增长 129.50% 到 181.66%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）营业收入：30,272.95 万元。

（二）利润总额：5,252.76 万元。归属于母公司所有者的净利润：4,115.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,834.34 万元。

（三）每股收益：0.24 元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2025 年度业绩预计较上年同期变化的主要原因如下：

报告期内，全球半导体市场持续回暖。其中，海外市场受到人工智能需求拉动，高端逻辑、存储芯片制造厂开工率持续提升，资本开支有所增加，带动公司大直径硅材料业务收入稳步增长；中国本土市场国产替代加速，资本开支持续增长，特别是存储芯片制造厂在技术和产能两方面紧跟全球先进水平，对关键耗材需求增加，带动公司硅零部件业务收入快速增长。

随着下游需求回暖向好，公司产能利用率提升，规模效应显现；叠加内部管理优化，毛利率与净利率同步提升，公司盈利能力稳步上行。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日